## Энтропия кристаллизации материалов из "расплавленной" подрешетки суперионных проводников

© М.А. Коржуев

Институт металлургии им. А.А. Байкова Российской академии наук, 117911 Москва, Россия

## (Поступила в Редакцию 17 марта 1997 г. В окончательной редакции 28 мая 1997 г.)

Показано, что энтропия кристаллизации материалов (Cu, Ag, Au, Li и др.) по схеме "расплавленная" подрешетка суперионных проводников (СИП) → кристалл может существенно превышать энтропию кристаллизации соответствующих веществ из расплава. Обнаруженная закономерность объясняет известную склонность ряда СИП к образованию нитевидных кристаллов (вискерсов) в твердой фазе, равно как и совершенную структуру последних.

Кристаллическую структуру суперионных проводников (СИП) можно представить как суперпозицию "расплавленной" подрешетки подвижных ионов (Cu<sup>1+</sup>, Ag<sup>1+</sup>, Li<sup>1+</sup>, H<sup>1+</sup>, F<sup>1-</sup>, C1<sup>1-</sup> и др.) и жесткого "остова", сохраняющего свойства твердого тела вплоть до температуры плавления соединения (*T<sub>m</sub>*). "Плавление" подрешетки подвижных ионов происходит обычно при температуре суперионного фазового перехода  $T_c \sim 0.3 - 0.4T_m$ , при этом часть ионов СИП возбуждается в междоузлия (дефекты Френкеля), где распределяется по большому числу пустот (фазовый переход порядок-беспорядок). Переход порядок-беспорядок вносит основной вклад (до 90%) в общую энтропию суперионного перехода  $\alpha_c = \Delta S_c / R_0 \ (R_0$  — универсальная газовая постоянная). деформация "остова" — оставшиеся 10%; в целом величина  $\alpha_c$  в СИП может достигать значительной величины (до единицы и более) [1-3]. Соответственно энтропия плавления / кристаллизации образцов СИП при температуре  $T = T_m$  заметно уменьшается  $(\alpha'_m \sim \alpha_m - \alpha_c)$ (здесь  $\alpha_m = \Delta S_m/R_0$  — приведенная энтропия плавления упорядоченного материала) (кривые 2 и 3 на рис. 1) [4,5], равно как и склонность слитков к огранению [6] (последнее хорошо проявляется обычно при  $\alpha_m > 4 - 6$  [7]).

Процессы кристаллизации в СИП возможны также в твердом состоянии по схеме "расплавленная" подрешетка СИП — кристалл (рост "вискерсов", лент, дендритов на основе Сu, Ag, Na и др.) [8–11]. Для Cu, Ag и Na имеем  $\alpha_m = 1.12, 1.17, 0.85$  соответственно [12], что предполагает поликристаллическую структуру и округлую форму поверхности образцов в случае их кристаллизации из расплава [7]. В то же время для "вискерсов" и лент [8–11] характерны монокристаллическая структура и частичная огранка, что указывает на возможное несоответствие величин  $\alpha_m$  и  $\alpha''_m$  (здесь  $\alpha''_m = \Delta S''_m/R$  — приведенная энтропия кристаллизации материалов из "расплавленной" подрешетки СИП). Величину  $\alpha''_m$  для СИП ранее специально не оценивали.

В настоящей работе показано, что величина  $\alpha''_m$  в СИП может существенно превышать энтропию кристаллизации тех же веществ из расплава  $\alpha_m$ .

Изменение конфигурационной составляющей энтропии при "плавлении" подрешетки подвижных ионов в СИП описывается выражением

$$\Delta S_i^{\text{conf}} = k_0 (\ln W_{T > T_c} - \ln W_{T < T_c}).$$
(1)

Здесь  $k_0 = R_0/N_0$  — постоянная Больцмана,  $N_0$  — число Авогадро,  $W = C_a^b = (b!)/((b-a)!a!)$  — статистический вес соответствующих состояний,  $C_a^b$  — число способов размещения *a* подвижных ионов *a* в *b* прустотах в кристалле [3,13,14].

Полагая в (1)  $a = b = nN_0$  ( $T < T_c$ ) и  $a = nN_0$ ,  $b = NN_0$  ( $T > T_c$ ) (n и N — число подвижных ионов и пустот, приходящихся на формульную единицу соединения), с помощью формулы Стирлинга



**Рис. 1.** Характерные температурные зависимости приведенной энтропии  $\alpha = S/R_0$  для упорядоченных веществ (1), СИП (2), аморфных тел (3) и "расплавленной" подрешетки подвижных ионов в СИП (4).  $T_c$ ,  $T_g$  и  $T_m$  — температуры суперионного перехода, стеклования аморфных тел и плавления кристаллов. Конфигурационное пространство: a — СИП (N = 10, случай Cu<sub>2-x</sub>Se [1,2]), b — жидкость (N = 2, "ячеистая" модель [15,16]), c — упорядоченная твердая фаза (N = 1).



**Рис. 2.** Зависимости конфигурационной составляющей приведенной энтропии разупорядочения подвижных ионов  $\alpha_i^{\text{conf}}$ от атомной доли подвижных ионов *n* при суперионном фазовом переходе в СИП (*1*-3). Параметр разупорядочения *N*: *I* — 100, *2* — 10 (случай Cu<sub>2-x</sub>Se), *3* — 2. *4* —  $\alpha_m^{\text{conf}} = \ln 2$ .

 $\ln(y!) \simeq y(\ln(y) - 1)$  при  $N \gg n \sim 1$  получаем

$$\alpha_i^{\text{conf}} = \Delta S_i^{\text{conf}} R_0$$
$$= \left( N \ln \frac{N}{N-n} + n \ln \frac{N-n}{n} \right) \sim \ln N. \quad (2)$$

На рис. 2 приведены зависимости  $\alpha_i^{\text{conf}} = f(n)$ , рассчитанные по формуле (2) при различных значениях параметра N (кривые 1-3). Там же представлены значения конфигурационной составляющей энтропии плавления для ячеистой модели жидкости  $\alpha_m^{\text{conf}} = \ln 2$  (линия 4) [15,16], вносящей основной вклад (до 70–80%) в полную энтропию плавления Cu, Ag, Au, Li, Na [12].

Из рис. 2 видно, что при N > 2 и n > 0.1в СИП оказывается возможным соотношение  $\alpha_m'' \sim \alpha_i^{\text{conf}} \sim \alpha_c M/M_i > \alpha_m^{\text{conf}} \sim \alpha_m (M_i$  — атомный вес подвижных ионов, возбудившихся в междоузлия, M — молекулярный вес СИП), что связано с бо́льшей степенью разупорядочения ионов в "распределенной" подрешетке СИП по сравнению с жидкостью. Последнее возможно за счет наличия жесткого "остова" СИП, увеличивающего размерность конфигурационного пространства для возможного разупорядочения ионов при  $I > I_c$  (рис. 1) [17].

Таким образом, при N > 2 и n > 0.1 подвижные ионы "расплавленной" подрешетки СИП могут обладать избыточной по отношению к обычному расплаву энтропией ( $\alpha''_m - \alpha_m$ ) ~  $\ln(N/2)$  (кривая 4 на рис. 1). Соответственно "кристаллизаций" подвижных ионов по схеме "расплавленная" подрешетка СИП  $\rightarrow$  кристалл отвечает изменение энтропии  $\alpha'' \sim \alpha_i^{conf}$ , превышающее энтропию кристаллизации тех же веществ из расплава  $\alpha_m$  (кривая  $4 \rightarrow$  кривая 1 на рис. 1).

Для селенида меди Cu<sub>2-x</sub>Se (структурный тип флюорита, N = 10,  $n \sim 1$  ("плавится" около половины меди) [8,17]) при кристаллизации подвижной меди из "расплавленной" подрешетки имеем  $\alpha''_m \sim 3.25$  (кривая 2 на рис. 2), что объясняет в рамках эмпирических соотношений [7] высокую скорость зарождения "вискерсов" меди на Cu<sub>2-x</sub>Se, их совершенную кристаллическую структуру, анизотропию роста и частичную огранку [8,9].

Максимальные значения параметров N и n в известных неорганических СИП достигают N = 21 для AgI,  $n \sim 2$ для Ag<sub>2</sub>HgI<sub>4</sub> и (Na<sub>2</sub>O)<sub>x</sub>(Li<sub>2</sub>O)<sub>y</sub>(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)<sub>11</sub> (плавятся две подрешетки соединений) [1,2], откуда получаем оценку предельного значения величины  $\alpha''_m \sim 5-6$  (рис. 2). В более сложных органических СИП и в биологических объектах за счет увеличения параметров N и/или nможно, по-видимому, наблюдать и более высокие значения  $\alpha''_m$ . Именно с большим  $\alpha''_m$  может быть связана повышенная склонность указанной группы материалов к росту новообразований [18]. Исследование физических свойств и фазовых превращений таких веществ может представлять особый интерес.

## Список литературы

- [1] Физика суперионных проводников / Под ред. М.Б. Саламона. Зинатне. Рига (1982). 316 с.
- [2] Ю.Я. Гуревич. Ю.И. Харкац. Суперионные проводники. Наука, М. (1992). 288 с.
- [3] M.J. Rice, S. Strassler, G.A. Toombs. Phys. Rev. Lett. 32, 596 (1974).
- [4] А.Ф. Полищук, Т.А. Тишура, А.Н. Бударина. УФЖ 40, 120 (1974).
- [5] М.А. Коржуев. Расплавы, 6, 105 (1991).
- [6] M.A. Korzhuev. Phys. Stat. Sol. 121, K7 (1991).
- [7] K.A. Jackson. In: Crystal Growth / Ed. S. Peiser. Pergamon Press, Oxford (1967). P. 13.
- [8] М.А. Коржуев, В.Ф. Банкина, Н.Х. Абрикосов, А.В. Аракчеева, М.А. Лобзов. ЖТФ 56, 797 (1986).
- [9] М.А. Коржуев. ФХОМ, 5, 153 (1993).
- [10] В.В. Вольский, Г.Л. Кошель, Н.В. Макухин. В сб.: Тез. докл. VII Всесоюз. конф. по физ. химии и электрохимии ионных расплавов и твердых электролитов. Наука, Л. (1983). Т. 3. С. 39.
- [11] Ю.М. Гербштейн, Е.И. Никулин, Ф.А. Чудновский. Там же. С. 43.
- [12] В.М. Глазов, А.А. Айвазов. Энтропия плавления металлов и полупроводников. Металлургия, М. (1980). 172 с.
- [13] Л. Жирифалько. Статистическая физика твердого тела. Мир. М. (1975). 382 с.
- [14] T. Tanaka, S. Miyazima, T. Kakiuchi, Y. Ota. Progr. Theor. Phys. Suppl., 115, 185 (1994).
- [15] С.М. Стишов. УФН 144, 3 (1974).
- [16] В.С. Воробьев. ЖЭТФ 110, 683 (1996).
- [17] М.А. Коржуев, В.В. Баранчиков, Н.Х. Абрикосов, В.Ф. Банкина. ФТТ 26, 7, 2209 (1984).
- [18] М.А. Коржуев. Письма в ЖЭТФ 64, 107 (1996).